

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2026 年 4 月制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2026 年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，通过优化经营策略、加强技术创新、完善公司治理等多方面举措，提升公司经营质量与盈利能力，维护投资者合法权益，促进公司可持续发展。现将公司 2026 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、深耕主业扩产拓品，经营效益持续向好

2026 年上半年，公司持续聚焦光刻材料、超高纯前驱体材料两大主业，以国产替代为核心主线，同步推进存量扩份额、高端破瓶颈、生产降成本、供应链强保障，经营规模与盈利水平实现了稳步提升。2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 34,138.11 万元，同比增长 15.98%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润达 4,533.50 万元，同比增长 47.48%。

其中，光刻材料作为公司核心营收支柱，完整布局涂层、多代次光刻胶配套产品矩阵，其中 SOC 碳膜、BARC 抗反射涂层、i-Line 负性光刻胶、KrF 光刻胶已实现长期稳定批量供货，批量导入国内多家头部存储、逻辑晶圆厂，产品在性能、缺陷控制、蚀刻匹配度等关键指标上向国际一线厂商水平看齐，助力下游供应链国产化推进，加速相关材料进口替代进程；ArF 浸没式光刻胶顺利通过客户全流程验证并实现小规模批量供货，SiARC、Top Coating 等高端配套涂层同步推进多家晶圆厂多轮工艺测试并取得某客户小批量订单，产品管线持续丰富完善。

前驱体材料业务以高纯硅基 TEOS 为核心主力产品，依托大连基地自主连续精馏纯化生产线，稳定产出 9N 超高纯度产品，充分满足各类芯片制造薄膜沉积工艺应用需求，出货量逐年稳步提升。公司同步布局其他金属基、High-K 前驱体研发和产业化，多款产品已进入客户验证阶段，部分新品已通过验证取得订单，逐步完善前驱体产品布局。

公司上半年完成对外投资设立合资公司相关工作，新设合资公司拟从事半导体旋涂型功能性材料及其配套材料的研发、生产和销售。此次投资合作充分发挥各合作方在工艺技术、下游晶圆客户资源与规模化生产能力等方面的优势，开拓新的产业领域，丰富公司面向晶圆制造客户的产品供给矩阵，更好匹配下游晶圆厂商对于旋涂类半导体材料的采购需求，为公司中长期业绩增长构建全新业务增长曲线。

二、加大研发投入，夯实核心技术壁垒

公司坚持创新驱动发展战略，严格落实行动方案研发攻坚相关部署，上半年持续加大资金、精密实验设备、专业研发人才等核心资源投入，聚焦半导体光刻材料、超高纯电子化学品等关键品类开展核心工艺攻关，持续巩固细分领域技术领先优势。2026 年 1-6 月，公司累计研发投入 6,112.40 万元，研发费用占营业收入比例 17.90%，较去年同期增长 46.92%。研发资源优先配置于高端光刻胶、前驱体、核心原材料树脂等重点半导体材料研发项目。

公司持续深化与国内重点高校、国家级半导体科研院所、上下游龙头企业的合作，积极参与半导体关键材料行业课题攻关，共建新材料联合实验室，整合资源开展研发试验工作。现阶段公司已搭建起覆盖半导体原材料及成品的配方设计、工艺开发、产业化应用验证的一体化、智能化研发平台，打通新品研发全链条，有效缩短新材料从实验室研发到批量供货的落地周期。同步推进研发人才队伍建设，针对化学材料、晶圆工艺应用等人才紧缺领域不断引进具备行业深耕经验的技术专家，搭建管理、技术双通道晋升机制，配套专项研发创新奖励，为长期技术迭代突破筑牢人才底座。

三、优化公司治理，实现合规透明运营

2026 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》及上海证券交易所科创板相关业务规则的要求，持续完善权责明确、有效制衡、协调运转的上市公司治理结构，切实加强对控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职监督。报告期内，公司董事会审议通过了《内部控制评价制度》《证券投资交易管理制度》，修订了《独立董事津贴制度》，进一步健全内控体系，规范内部运作。通过系列制度制定与修订工作，进一步夯实内部控制基础，规范证券投资运作流程，完善证券交易约束机制，持续提升公司治理规范化水平。公

司持续开展内部控制自我评价及专项审计工作，重点围绕货币资金管理、关联交易、募集资金使用及募投项目实施、对外投资等领域，完善配套制度与操作流程，确保公司治理和信息披露合法合规。

2026 年上半年，公司按时编制并披露了定期报告及临时公告，信息披露工作严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司通过规范透明的治理运作，有效保障全体投资者的知情权，切实维护中小投资者合法权益。

四、畅通交流渠道，深化投资者沟通

2026 年上半年，公司持续完善常态化投资者沟通机制，不断丰富交流载体、拓宽沟通渠道，切实保障广大中小投资者依法享有的知情权、参与权，搭建资本市场与公司经营发展高效互通的交流桥梁。

公司分别于 2026 年 1 月 7 日及 6 月 24 日举办线下投资者调研活动，累计接待机构及个人投资者近百人次。同时，公司通过业绩说明会、上证 E 互动平台、投资者热线、IR 邮箱等多种渠道与投资者保持常态化交流，就市场关注的产品研发进展、产能释放计划、分红政策规划及国产替代市场空间等问题开展交流沟通，持续向资本市场传递公司作为国产半导体材料企业的长期发展逻辑。报告期内，公司中长期机构投资者持仓比例稳步提升，资本市场认可度持续改善。

五、强化人才风控，保障各项举措落地

人才梯队建设与全域风险防控作为行动方案落地的底层保障，报告期内公司同步推进、双向发力，全方位支撑“提质增效”各项工作平稳推进。人才建设方面，围绕研发技术、市场拓展、生产运营、企业管理四大紧缺赛道定向引进行业高端专业人才；落地差异化薪酬定级、项目攻坚专项奖励等多元激励工具，搭建系统化岗前培训、技能进阶、管理储备培养体系，打造创新、担当、协同、高效的企业文化，充分释放团队创造力与组织运营活力。风险防控方面搭建覆盖宏观环境、行业周期、经营业务、技术迭代、财务资金的全维度动态管控体系。持续跟踪宏观经济走势、半导体行业资本开支周期、核心原材料价格波动，动态调整生产排产、原料采购及市场拓展策略；持续优化客户与供应商结构，积极拓展多元化客户渠道，丰富原材料采购来源，稳步提升业务布局均衡性；紧密跟随下游客户工艺发展路线开展产品开发，适配客户不同阶段技术升级需求，持续丰富产品谱系，积极应对行业技术迭代带来的市场变化；按月滚动开展全公司现金流测

算，严格管控投融资、大额资金支付审批流程，筑牢财务安全底线，为全年“提质增效重回报”行动方案的落地保驾护航。

六、统筹平衡发展与股东回报

公司重视维护股东合法权益，股东回报依赖于稳定的经营业绩与充足现金流支撑。报告期内，公司集中资源投入研发、业务拓展等领域，资本开支与研发投入加大，公司未能实现 2025 年度的现金分红、送转股等股东回报安排。公司将持续做强主业、提升盈利水平，以此夯实股东回报基础。后续将综合考量公司经营业绩、现金流、资本开支计划等条件，审慎研究各类股东回报方式的可行性，相关事项如推进将严格履行内部决策及信息披露义务，相关安排存在不确定性，不构成对投资者的承诺。

七、总结

2026 年上半年，公司对照 2026 年度行动方案的规划逐项落地执行，经营发展、技术创新、规范治理、投资者回报、投资者沟通、人才风控全部板块均取得阶段性积极成效，整体落地进度符合年度预设目标，各项提质增效、回馈投资者举措有序落地、进展良好。

下半年，公司将进一步深化主业降本增效与各系列产品市场放量，加大前沿半导体新材料核心技术攻关力度，持续审慎研究中长期股权激励等长效回报机制的可行性，持续优化常态化投资者沟通渠道，迭代完善人才激励与全域风险防控体系。公司将依靠持续改善的经营业绩、更加透明规范的治理运作、稳定可持续的股东回报，稳步提升企业内在价值，回馈广大投资者的长期信任与支持。

本报告所涉及的公司规划、发展战略、股东回报等系非既成事实的前瞻性陈述，该等陈述基于公司当前可获取信息作出，受行业周期、市场环境、客户验证进度等多重不确定因素影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日